

METEORWAVE® 2000

超低損失材料

積層板およびプリプレグ

メリット

- 優れた電気性能
- 広い周波数帯域にわたる安定な誘電性能
- 高いCAF耐性
- 様々な構造で利用可能

用途

- 25 GHz以上、インフラストラクチャ
- コアルーター
- 高速スイッチ
- クラウドストレージ



Meteorwave® 2000高速・超低損失材料は、次世代に向けて優れた電気性能と高い信頼性を実現します。コアルーター、高速スイッチ、スーパーコンピュータ、および低信号減衰と高データ転送速度が欠かせない用途での使用に向けて設計されています。

優れた電気特性

- 極低損失
- 様々な環境条件下で各周波数に対するDk/Df値の安定性
- 低Dk

熱特性および機械的特性

- 高信頼性を実現する非常に低いZ軸膨張率
- 鉛フリー組立に適合
- 良好な剥離強度
- 優れたIST性能

優れたCAF耐性

- 高温リフロー後のCAF耐性材料

高Tg FR-4加工

- 他の高Tg材料と同様の工程
- 216°Cおよび400 ~ 500 psiで90分間硬化

UL 94 V-0、IPC-4101/102規格に対応

UL File Number: E36295

特性	条件	標準値	単位	テスト方法
電気特性				
誘電率	@ 2 GHz	3.3		IPC-TM-650.2.5.5.5
	@ 10 GHz	3.2		
誘電正接	@ 2 GHz	0.0027		
	@ 10 GHz	0.0034		
体積抵抗率	C - 96 / 35 / 90	3.60 x 10 ⁷	MΩ - cm	IPC-TM-650.2.5.17.1
	E - 24 / 125	2.60 X 10 ⁸		
表面抵抗率	C - 96 / 35 / 90	2.10 X 10 ⁶	MΩ	IPC-TM-650.2.5.17.1
	E - 24 / 125	1.10 x 10 ⁸		
耐電圧		4.6x10 ⁴ (1800)	V/mm (V/mil)	IPC-TM-650.2.5.6.2
熱特性				
*ガラス転移温度 (Tg)	DMA(°C) (Tan d Peak)	240	°C	IPC-TM-650.2.4.24.3
分解温度 (TGA)	Degradation Temp (TGA) (5% wt. loss)	390	°C	IPC-TM-650.2.3.40
T-300	Time to delamination @ 300°C	>120	minutes	IPC-TM-650.2.4.24.1
熱伝導率		0.43	W/mK	ASTM E1461
機械的特性				
剥離強度	1 oz (35μ) Cu	1.05 (6.0)	N/mm (lbf/inch)	IPC-TM-650.2.4.8
	After Solder Float	1.16 (6.6)	N/mm (lbf/inch)	IPC-TM-650.2.4.8
X / Y CTE	-40°C to + 125°C	10 - 14	ppm/°C	IPC-TM-650.2.4.41
Z 軸膨張係数 Alpha 1 / Alpha 2 (55% RC)	50°C to Tg / Tg to 260°C	55 / 260	ppm/°C	IPC-TM-650.2.4.24
Z 軸膨張 (43% RC)	50°C to 260°C	1.5	%	IPC-TM-650.2.4.24
ヤングモジュラス (X/Y)		18.3 / 17.0 (2.7 / 2.5)	GN/m ² (psi x 10 ⁶)	ASTM D3039
ポアソン比 (X/Y)		0.166 / 0.169		
化学的/物理的特性				
吸湿		0.12	wt. %	IPC-TM-650.2.6.2.1

* DMAはTg測定に好ましい方法であり、他の方法より正確な測定が可能。

- ここに示したすべての試験データは典型的な値であり、規格値を意図したものではありません。重要な仕様の公差に対する評価については、弊社の担当者に直接お問い合わせください。
- Meteorowave® 2000において、2.0ミル (0.05 mm) 以上の厚さでご提供できます。
- Meteorowave® 2000は、ほとんどの一般的なパネルサイズでご提供できます。
- この他の積層体の構造や低粗度銅箔であるRTFOIL®を含む使用可能な銅箔種、ガラスクロス種等については直接弊社にお問い合わせください。

